

## 苏州日月新半导体有限公司



加入日月光 共创科技未来

苏州日月新半导体有限公司于 2007 年由日月光与恩智浦(NXP)合资设立, 2018 年日月光集团取得 100% 股权, 是日月光在中国半导体封装测试产业中的重要厂区之一。以卓越技术、创新思维与高阶研发能力持续发展并提供客户包括 IC 封装、前段工程测试、晶圆针测和成品测试以及电子制造的一元化服务。现有员工超过 2700 名, 日月新重视品质、研发、技术、人才培育、员工沟通、员工健康与福利。

苏州日月新提供先进的制造工艺技术, 包括倒装芯片封装(Flip Chip)、测试和系统级封装(SiP) 提供 QFN/DFN、LFBGA、SO、TSSO 与应用于手持式装置的封装产品。



### 招聘岗位：

#### 黏晶制程工程师(DB PE)

##### 要求：

- ◆ 本科学历
- ◆ 英语 CET4
- ◆ 3 年以上 FC Die bond 的工作经验

#### 焊线制程工程师(WB PE)

##### 要求：

- ◆ 本科学历
- ◆ 英语 CET4
- ◆ 2 年以上半导体前段制程相关经验

#### 后道制程工程师(BE PE)

##### 要求：

- ◆ 本科学历
- ◆ 英语 CET4
- ◆ 2 年以上半导体相关工作经验
- ◆ 具有 Sputter/Shielding 工作经验的优先

#### 新产品导入(NPI)工程师

##### 要求：

- ◆ 大专以上学历
- ◆ 英语四级以上水平
- ◆ 3 年以上相关工作经验
- ◆ 熟练使用 office 办公软件



## 质量(QE)工程师

### 要求：

- ◆ 本科学历，理工科类专业
- ◆ 英语 CET4
- ◆ 熟悉品质相关知识(七大手法，抽样检验等)

## 测试工程师

### 要求：

- ◆ 本科学历，电子信息等相关理工科类专业
- ◆ 英语 CET4
- ◆ 1-3 年工作经验
- ◆ 半导体芯片测试相关经验射频相关经验优先

## 盖印(MK)工程师

### 要求：

- ◆ 本科学历
- ◆ 英语 CET4
- ◆ 3 年以上半导体相关工作经验
- ◆ 具有 MK 站新产品新制程导入，相关异常处理工作经验优先

## 设备技术员

### 要求：

- ◆ 大专学历，理工科相关专业
- ◆ 半导体相关作业/设备维修经验尤佳
- ◆ 能适应 12 小时工时制，上四休二轮班，无尘室工作环境
- ◆ 优秀应届毕业生亦可

## 作业员、品检员

### 要求：

- ◆ 中专/高中及以上学历
- ◆ 18-35 周岁、女性尤佳
- ◆ 能适应 12 小时工时制，上四休二轮班，无尘室工作环境
- ◆ 站立工作，品检员需要看显微镜

## 工业(IE)工程师

### 要求：

- ◆ 本科学历，工业工程专业
- ◆ 半导体封测厂工作 2 年及以上
- ◆ 熟悉封测流程

## 倒装芯片黏晶(FCDB)制程工程师

### 要求：

- ◆ 大学本科学历
- ◆ 英语四级水平
- ◆ 三年以上 IC 封装 FCDB PE 经验

## 厂务工程师

### 要求：

- ◆ 大专及以上学历，电气工程及自动化相关专业
- ◆ 两年以上半导体厂务工作经验，熟悉电力系统，二次配(hook up)经验
- ◆ 制程空压、真空、PCW 等或空调无尘室运转经验优先

## 设备维修技术员

### 要求：

- ◆ 具有半导体相关作业/设备维修经验尤佳
- ◆ 具有半导体 G/S 或者 D/B 或 W/B 或 M/D 或 M/K 或 Test 或 SMT 设备维修经验优先考虑
- ◆ 能适应 12 小时工时制，上四休二轮班，无尘室工作环境
- ◆ 优秀应届大专生亦可



## 联系方式：

**特殊时期，日月新启用视频面试流程**

**招聘无接触，求职心接触**

**地址：** 江苏省苏州市苏州工业园区苏虹西路 188 号

**电话：** 0512-67251788 分机 3458

**E-mail：** [xiaoxiao.li@aseglobal.com](mailto:xiaoxiao.li@aseglobal.com)

日月新更多职位  
请扫以下二维码



关注日月光集团公众号，扫描二维码  
了解行业最新资讯

